



TG-ASD50AB

熱伝導ゲル

REACH Compliant RoHS Compliant UL Comparable

製品特長

- ・ 高い熱伝導性
- ・ 早く固まる / 低粘度
- ・ 作業容易
- ・ 加熱硬化

応用範囲

電子元件 Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

保管条件

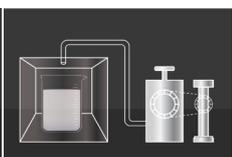
未開封の状態です室温 25°C 以下に 12 ヶ月保存出来。

取扱説明書

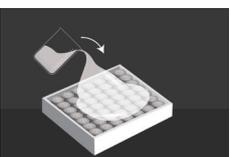
Pot



① Mix component A and B.

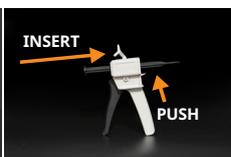


② Vacuum out air.



③ Pour potting compound.

Tube



① Push the latch and insert the stick.



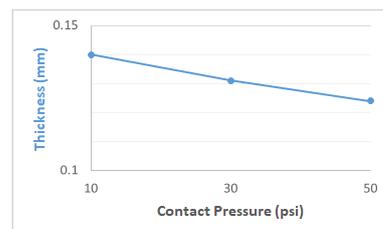
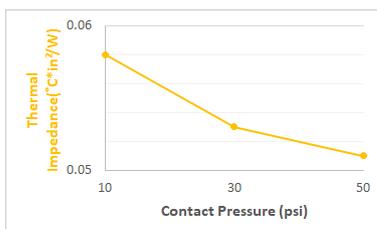
② Put the tube in.



③ Close the cover.

製品物性

Curing Contact Pressure, Thermal Impedance, and Thickness



Properties	Unit	TG-ASD50AB	Tolerance	Test Method
熱伝導率	W/m·K	5.0	±0.5	ISO 22007-2
色	-	A:Green / B:White	-	ASTM D2244
耐電圧	kV/mm	5	±3	ASTM D149
体積熱抵抗	Ohm·m	10 ⁹	10 ⁸ ~10 ¹⁰	ASTMD257
密度	g/cm ³	3.05	±0.15	ASTM D792
使用温度範囲	°C	-50~+150	-	-
重量損失	%	<1	-	By T-Global
粘性 @1.0rpm	Pa·s	A:250 / B:250	±100	ASTM D7395 ASTM D4287
伸び	%	>100	-	ASTM D412
引張り強さ @T3.0mm	kgf/cm ²	3	-	ASTM D412
硬化時間 @25° C	Min	120~240	-	-
硬化時間 @50° C	Min	40~60	-	-
硬化時間 @80° C	Min	20~40	-	-
標準仕様	-	Pot / Tube	-	-
混合比	-	1:1	-	-
硬さ	Shore OO	40	±10	ASTM D2240

▶ A 剤と B 剤は混合材料で、密度の異なりにより層は成されます。そういう現象は普通ですので、ご安心ください。使用する前にヘラ平型スクレーパーやステンレス製器具で A 剤と B 剤を別々にゆっくり混ぜ合わせてください。そうしたら優れた熱伝導効果を作れます。

T-Global Technology 株式会社

〒 108-0075 東京都港区港南 2-16-4 品川グランドセントラルタワー

T +81-3-6863-6387 E japan@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version21
20260127



注意：本技術からのデータ情報は T-Global からの研究や検査により出てきた最も良い結果です。データ上の数は典型的な数字で、各バッチ製品を検査することではありません。もしスペックが変更されたら、別に通知することはありません。製品の効能に影響を与えられない保護フィルムが剥離紙と保護フィルムは製品の効率に影響を与えられません、特別な要望があれば、T-Global の評価を基準にします。各種の可能な使用条件が弊社のコントロールできる範囲を超えることで、弊社は提出させていただきましたアドバイスは何の保証や責任が生じることがありません。ですので、お客様は製品を試しながら、弊社の製品が各種の条件で応用できるかどうかご確認ください。本製品を売買する時には何か特定のところで応用できることを保証することがありません。但し、本製品が T-Global とお互いに確認した invoice、お見積りやご注文に基づき、基準的な品質を提供させていただきます。我々は使用者がどのように本技術からのデータ情報を使うことに責任を持ちません。一方、本技術から生み出されたデータ情報は説明内容や製品に関する用途、未来特許衝突、工芸製造や製品の使用についてのアドバイスなどが含まれておりません。